

RX140 グループ

スマートウェイクアップソリューション (タッチレスデモ)

要旨

本アプリケーションノートは、RX140 グループ スマートウェイクアップソリューションを応用したタッチレスデモについて説明します。

動作確認デバイス

RX140 (R5F51406ADFN)

関連ドキュメント

1. RX140 グループ 静電容量タッチ評価システムユーザーズマニュアル(r12uz0102jj0100)
2. RX140 グループ スマートウェイクアップソリューション(r11an0613jj0100)
3. RA2L1 グループ タッチレスボタンデモソリューション ハードウェア(r01an5812jj0101)

目次

| | |
|---------------------------|----|
| 1. 概要 | 3 |
| 2. 動作確認済環境 | 4 |
| 3. デモについて | 4 |
| 3.1 デモ構成 | 4 |
| 3.2 動作方法 | 4 |
| 4. 機能詳細 | 5 |
| 4.1 低消費電力待ち受け | 5 |
| 4.2 復帰後の通常動作 | 6 |
| 5. ソフトウェア仕様 | 7 |
| 5.1 ソフトウェア構造 | 7 |
| 5.2 ファイル構成 | 8 |
| 6. 静電容量タッチ設定 | 9 |
| 6.1 タッチインタフェース構成 | 9 |
| 6.2 構成（メソッド）の設定 | 9 |
| 6.3 チューニング結果 | 10 |
| 7. 消費電力 | 11 |
| 7.1 低消費電力待ち受け時の動作条件 | 11 |
| 8. 消費電力測定 | 11 |
| 改訂記録 | 12 |

1. 概要

本ソフトウェアは、RX140 に搭載されている、GTSU2SL の自動判定機能および複数電極接続 (TS 全端子出力制御ビット: 有効) 機能を使用することで低消費電力での待ち受けを実現します。近接操作にて低消費電力待ち受けモードから復帰することができ、復帰後は、近接操作に応じて LED の点灯およびブザー音を出力します。図 1.1 に動作イメージ図を示します。

※ 複数電極接続機能:

複数の自己容量電極をマイコン内部で接続し 1 つの電極として計測できる機能です。複数電極を 1 回で計測できるため計測時間が短縮され消費電力を削減できます。使用例としては、任意のボタン押下で低消費電力モードから復帰するシステムが挙げられ、従来、電源ボタンのみで復帰するシステムを複数のボタンで復帰するシステムとすることでユーザビリティを向上させることが可能です。

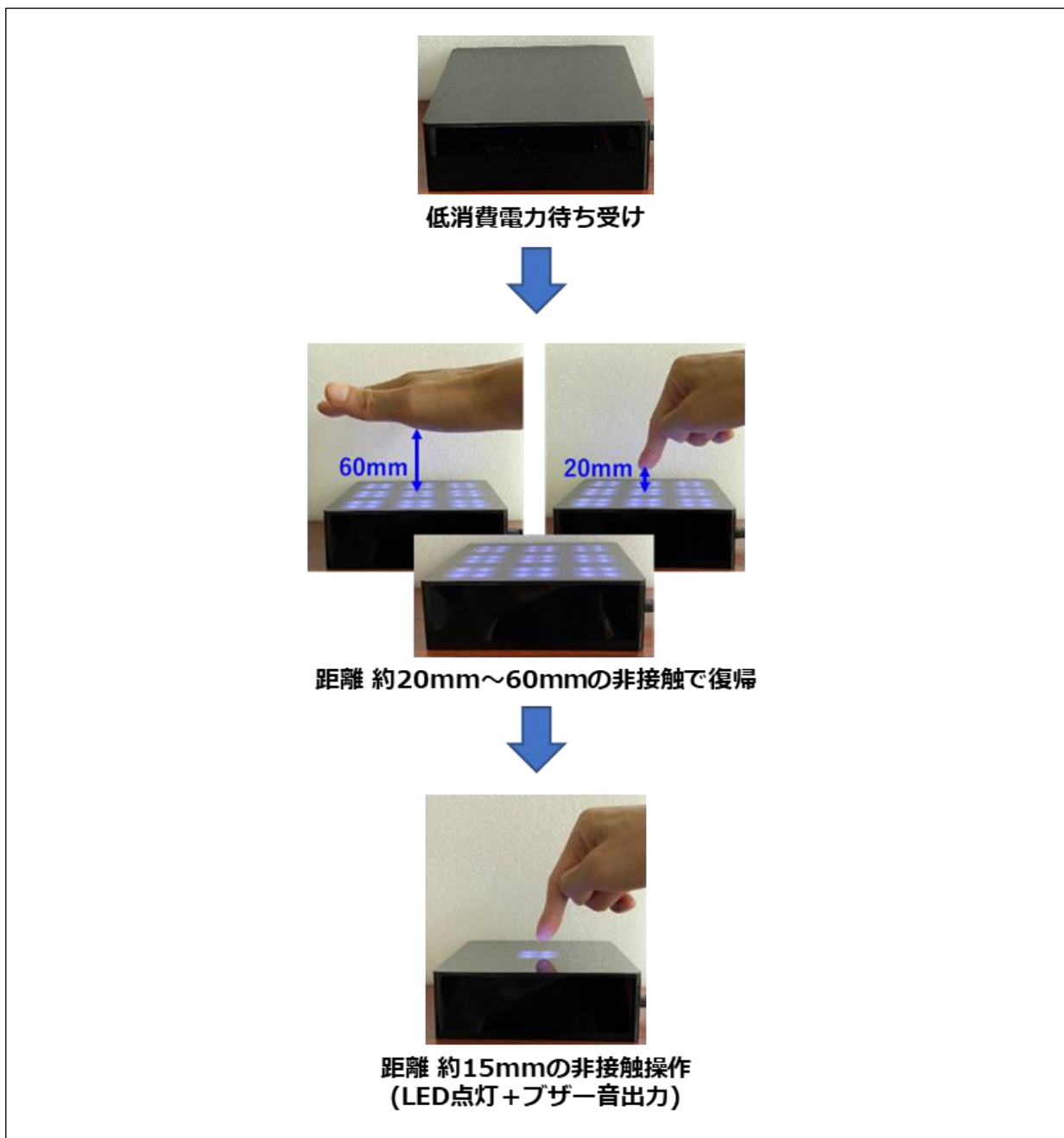


図 1.1 動作イメージ図

2. 動作確認済環境

本ソフトウェアの動作確認済環境を表 2.1 に示します。

表 2.1 動作確認済環境

| 項目 | 内容 |
|--|-----------------------------------|
| 使用マイコン | R5FA51406ADFN (RX140 MCU グループ) |
| 動作周波数 | 48MHz |
| 動作電圧 | 5V |
| 統合開発環境 | e ² Studio 2022-04 |
| C コンパイラ | CC-RX v3.04.00 |
| OCD エミュレータ | E2 エミュレータ Lite |
| QE for Capacitive Touch | V3.10 |
| CTSU QE API (r_cts_u_qe) [QE CTSU モジュール Firmware Integration Technology] | V2.10 |
| Touch QE API (rm_touch_qe) [QE TOUCH モジュール Firmware Integration Technology] | V2.10 |

3. デモについて

3.1 デモ構成

本デモは、タッチレスボタンデモ(型名：RTK0EG0036D01001BJ)に搭載されている RA2L1 CPU ボードを RX140 CPU ボード(型名：RTK0EG0038C01001BJ)に変更した構成です。

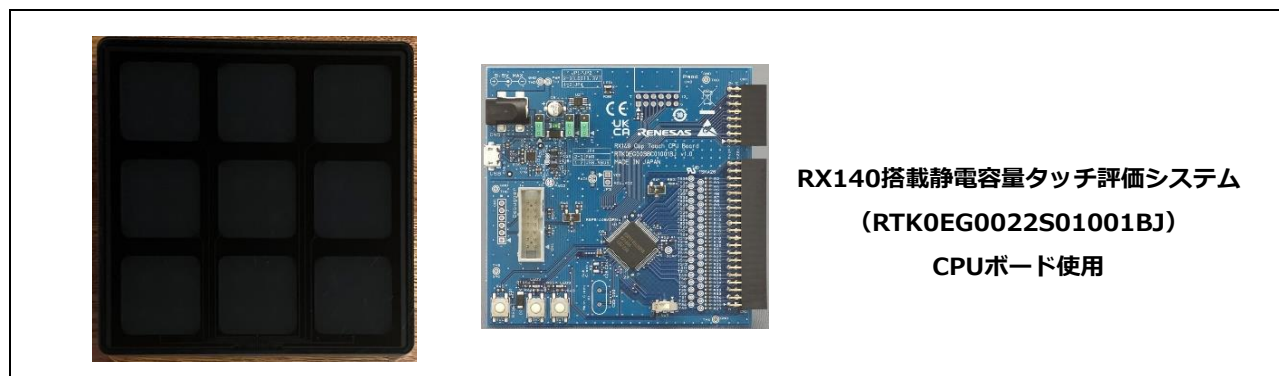


図 3.1 CPU ボード

3.2 動作方法

図 3.2 の青枠部の USB コネクタに電源供給することでデモを開始します。

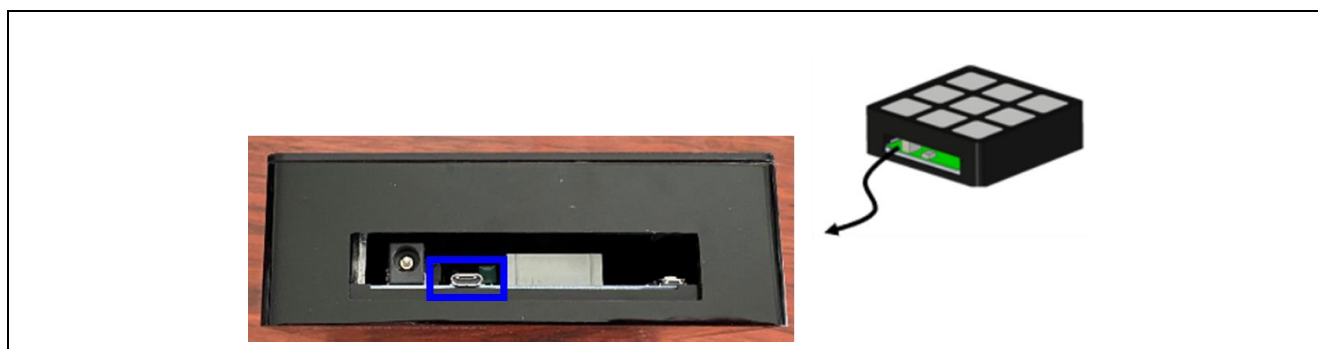


図 3.2 電源供給部

4. 機能詳細

本ソフトウェアの機能は、以下の通りです。

1. 自動判定機能および複数電極接続機能を使用した低消費電力待ち受け
2. 復帰後の通常動作 (タッチ操作に応じた LED 点灯およびブザー音出力)

4.1 低消費電力待ち受け

CTS2SL モジュール、DTC モジュール、LPC モジュール、LPT モジュール、ELC モジュールを使用します。

- ・ LPC を使用して MCU を低消費電力モードに遷移します。
- ・ 計測開始トリガを LPT のコンペアマッチ割り込みの外部トリガ(ELC からのイベント入力)に設定し、ソフトウェアスタンバイモード中に 100msec 間隔で CTS2SL の計測を行います。
- ・ スヌーズモード中の CTSU 計測動作は、DTC を使用します。
- ・ CTS2SL の自動判定機能を使用することで、スヌーズモード中に CTSU 計測を行った結果、タッチ ON 判定が検出されなければ CPU を起動することなく再度ソフトウェアスタンバイに遷移します。
- ・ CTS2SL の複数電極接続機能を使用することで、9ch を 1 回で計測し消費電力を削減します。
- ・ 下記の非接触操作で、低消費電力待ち受けモードから通常動作モードに遷移します。
 - 1 つボタンに指を近づける : 約 20mm
 - 9 つのボタンを手のひらで覆う : 約 60mm

図 4.1 に CPU 動作モードと CTSU 動作状態のイメージを示します。

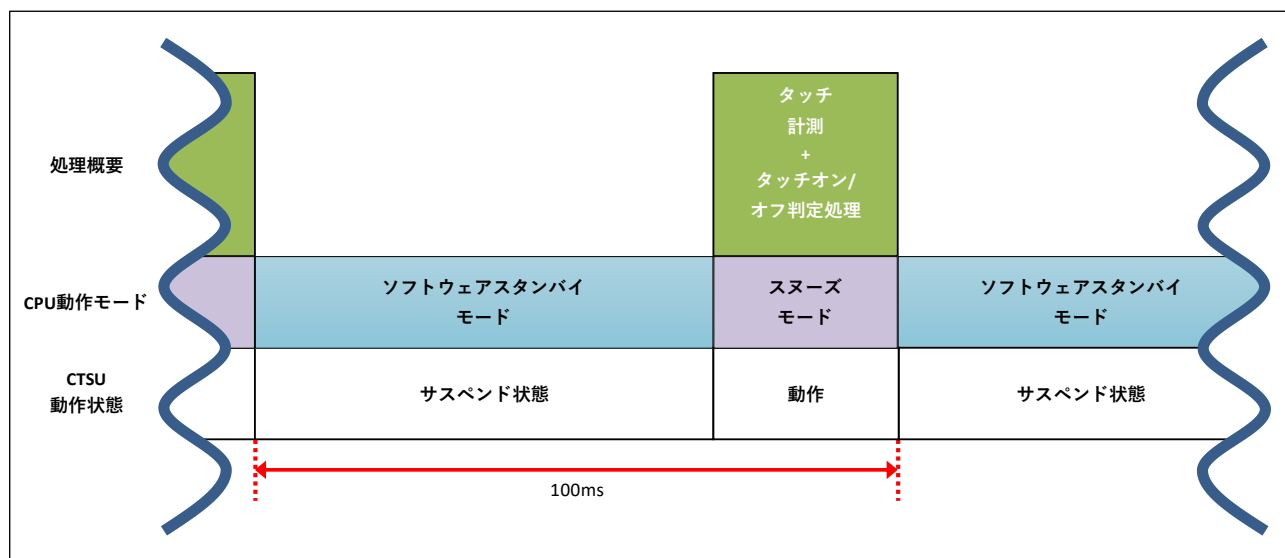


図 4.1 CPU 動作モードと CTSU 動作状態のイメージ

4.2 復帰後の通常動作

CTSU2SL モジュールを使用します。

- ・ 各ボタンに対して約 15mm の非接触操作で LED の点灯およびブザー音を出力します。
- ・ 非タッチ状態で 15 秒経過もしくは図 4.2 のように対角線上のボタン 2 つを同時に 3 秒認識させることで、通常動作モードから低消費電力待ち受けモードへ遷移します。

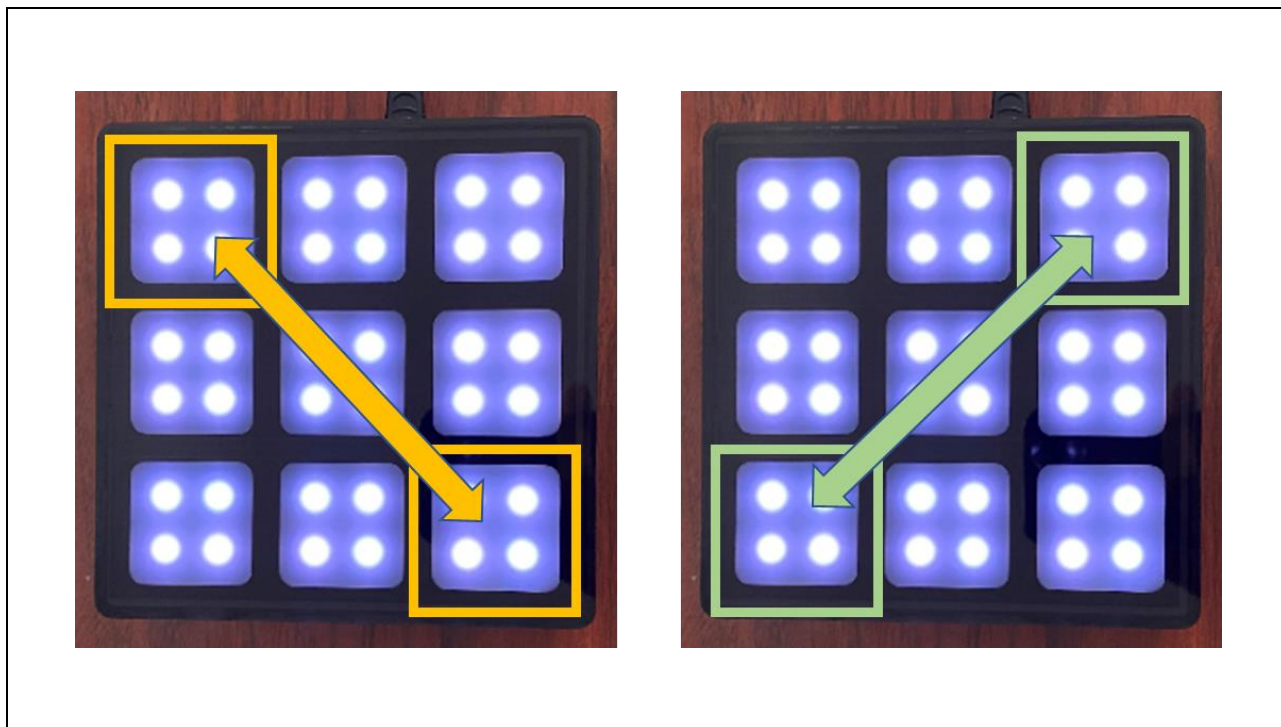


図 4.2 操作での低消費電力待ち受けモードへ遷移方法

5. ソフトウェア仕様

5.1 ソフトウェア構造

ソフトウェア構造図を図 5.1 に示します。

静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch と、RX スマート・コンフィグレータを使用し、下記モジュールを追加してアプリケーションを作成しています。

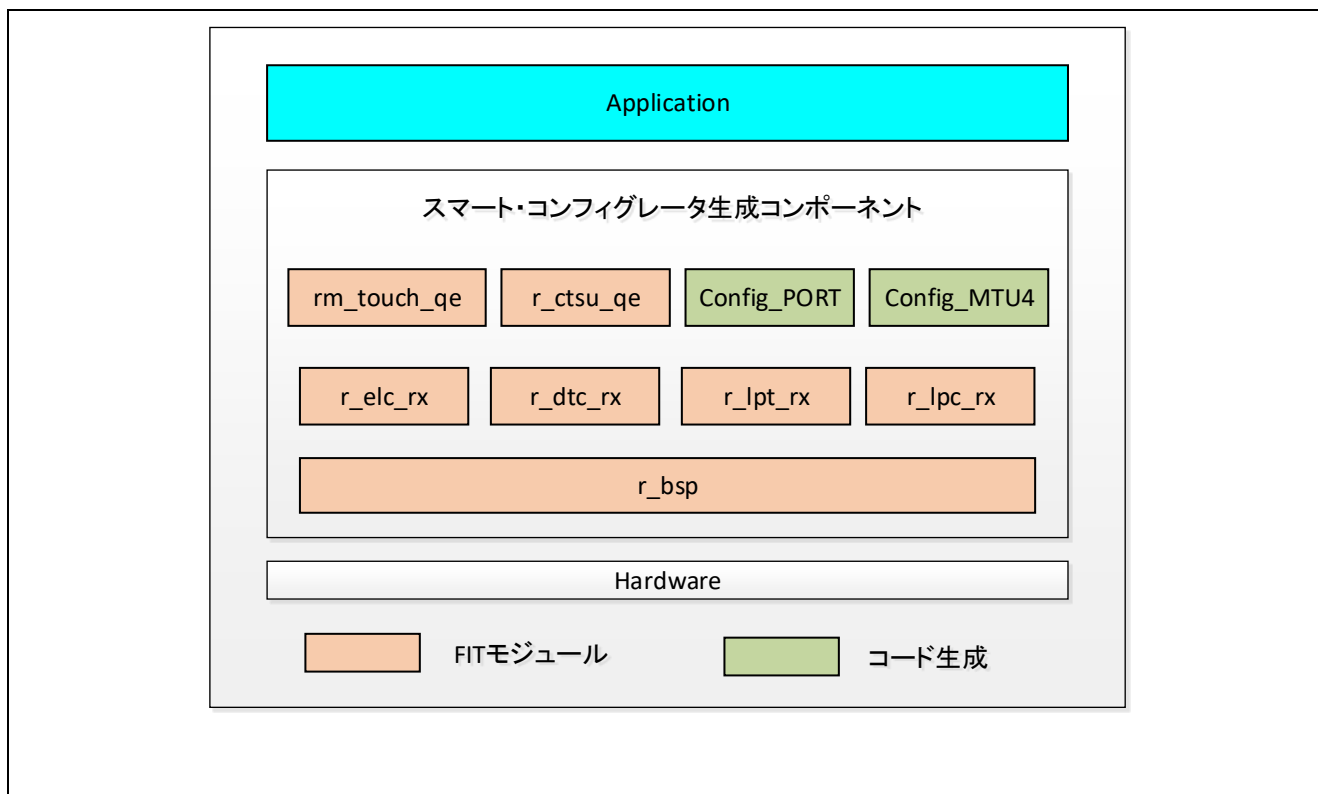


図 5.1 ソフトウェア構造図

表 5.1 にコンポーネントを示します。コンポーネントの設定は、スマート・コンフィグレータを参照してください。

表 5.1 コンポーネント一覧

| コンポーネント | バージョン |
|-------------|--------|
| r_bsp | 7.10 |
| r_lpc_rx | 2.03 |
| r_ctsu_qe | 2.10 |
| r_dtc_rx | 3.90 |
| r_elc_rx | 2.01 |
| r_lpt_rx | 3.01 |
| rm_touch_qe | 2.10 |
| Config_PORT | 2.3.0 |
| Config_MTU4 | 1.11.0 |

5.2 ファイル構成

図 5.1 にソースファイルツリーを示します。

スマート・コンフィグレータのファイルは省略します。



図 5.1 ソースファイルツリー

表 5.2 にソースファイルを示します。

表 5.2 ソースファイル

| ファイル名 | 内容 |
|--------------------------------|-----------------------|
| smart_wakeup_rx140_touchless.c | メインソースファイル |
| r_board_control.c | ボード制御ソースファイル |
| qe_touch_config.c | Touch QE 構成定義ソースファイル |
| qe_touch_sample.c | Touch QE アプリケーションファイル |

表 5.3 にヘッダファイルを示します。

表 5.2 ヘッダファイル

| ファイル名 | 内容 |
|-------------------|----------------------|
| r_board_control.h | ボード制御ヘッダファイル |
| qe_touch_config.h | Touch QE 構成定義ヘッダファイル |
| qe_touch_define.h | Touch QE 構成定義ヘッダファイル |

6. 静電容量タッチ設定

本ソフトウェアのタッチインタフェース構成、構成(メソッド)の設定、QE のチューニング機能を使用したチューニング結果を示します。

6.1 タッチインタフェース構成

図 6.1 にタッチインタフェース構成を示します。

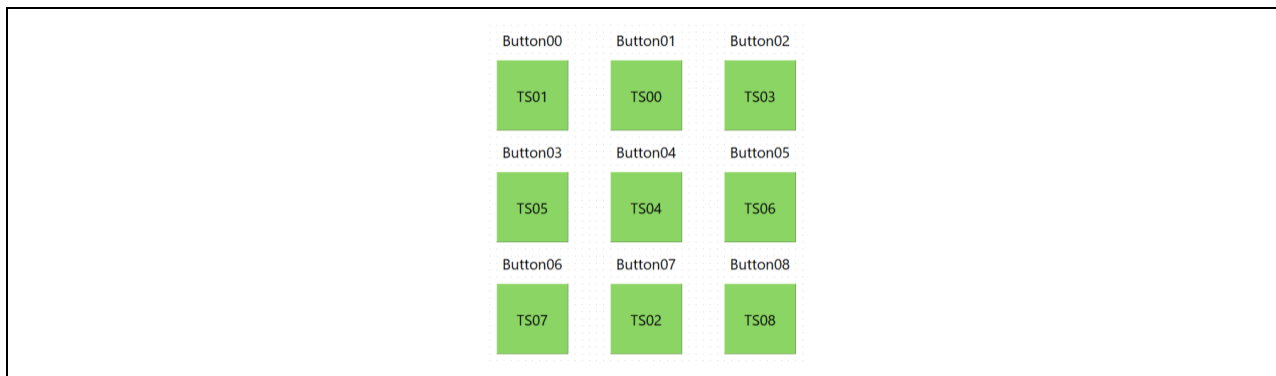


図 6.1 タッチインタフェース構成画面

6.2 構成(メソッド)の設定

図 6.2 にタッチインタフェース構成を示します。config01、config02 とともにすべてボタンとして設定しています。自動判定機能と複数電極接続は config01 のみ有効に設定しています。

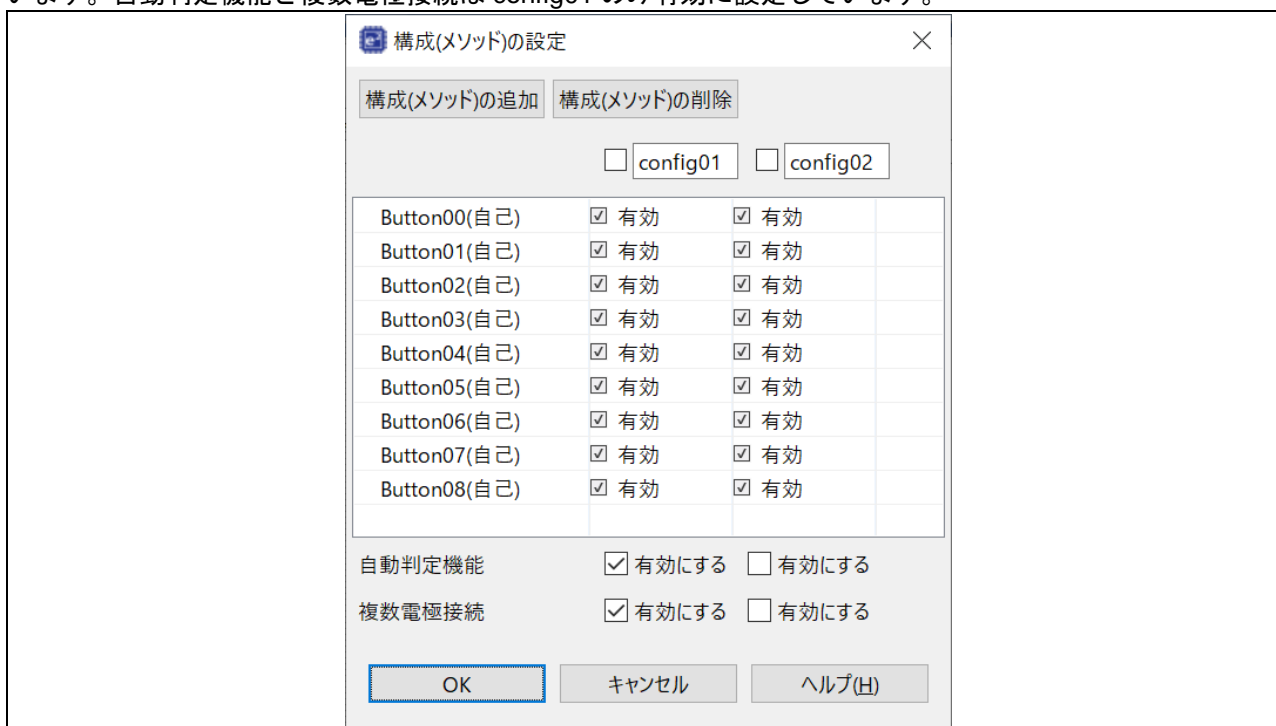


図 6.2 構成(メソッド)の設定画面

6.3 チューニング結果

QE チューニングでのチューニング結果を示します。本ソフトウェアは、結果一覧に示される設定値で動作しています。

表 6.1 チューニング結果一覧

| メソッド | 名前 | タッチセンサ | 寄生容量 [pF] | ドライブパルス周波数 [MHz] | 閾値 | 計測時間[ms] | so | snum | sdpa |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|-----|----------|-------|------|------|
| config01 | mec00 | TS00 | 219.208 | 0.5 | 120 | 0.064 | 0x3BE | 0x03 | 0x1F |
| config02 | Button00 | TS01 | 32.757 | 1 | 120 | 0.128 | 0x0C3 | 0x07 | 0x0F |
| config02 | Button01 | TS00 | 30.819 | 1 | 120 | 0.128 | 0x0B7 | 0x07 | 0x0F |
| config02 | Button02 | TS03 | 28.354 | 1 | 120 | 0.128 | 0x09F | 0x07 | 0x0F |
| config02 | Button03 | TS05 | 32.576 | 1 | 120 | 0.128 | 0x0C7 | 0x07 | 0x0F |
| config02 | Button04 | TS04 | 29.708 | 1 | 120 | 0.128 | 0x0AC | 0x07 | 0x0F |
| config02 | Button05 | TS06 | 29.347 | 1 | 120 | 0.128 | 0x0A7 | 0x07 | 0x0F |
| config02 | Button06 | TS07 | 30.965 | 1 | 120 | 0.128 | 0x0B6 | 0x07 | 0x0F |
| config02 | Button07 | TS02 | 27.889 | 1 | 120 | 0.128 | 0x09A | 0x07 | 0x0F |
| config02 | Button08 | TS08 | 29.806 | 1 | 120 | 0.128 | 0x0AC | 0x07 | 0x0F |

so : センサオフセット設定の変数

snum : 計測期間設定の変数

sdpa : クロック分周設定の変数

注 1 : 結果一覧の値は QE チューニング時の動作環境に依存するため、再度 QE チューニングするとこれらの値が変化する可能性があります。

注 2 : 黄色のマーカ部分は手動で値を変更しています。

注 3 : qe_touch_config.c 内、g_qe_ctsu_cfg_config01 の設定の一部を手動で変更しています。

tlot = 2 → 1 / thot = 2 → 1 / ajbmat = 7 → 4

7. 消費電力

7.1 低消費電力待ち受け時の動作条件

表 7.1 に低消費電力待ち受け時の動作条件を示します。

表 7.1 低消費電力待ち受け時の動作条件

| 項目 | 内容 |
|---------------------------|--|
| CPU 動作周波数 | 24MHz 高速オンチップオシレータ(HOCO) 32KHz 低速オンチップオシレータ(LOCO) |
| システックロック (ICLK) | 6MHz |
| 周辺クロックモジュール B (PCLKB) | 6MHz |
| 周辺クロックモジュール D (PCLKD) | 6MHz |
| タッチ計測周期 | 100ms |
| センサドライブパルス周波数 | 0.5MHz |
| CTSU 計測モード | 自己容量方式(MD1 = 1) |
| CTSU スキャンモード | マルチスキャンモード(MD0 = 0) |
| CTSU 計測動作開始トリガ選択 | 外部トリガ(CAP = 1) |
| CTSU 待機時省電力有効 | 待機時省電力機能有効 (SNZ = 1) |
| CTSU 電源動作モード | 通常電圧動作モード(ATUNE0 = 0) |
| CTSU 電流範囲調整 | 40 μ A (ATUNE1 = 1, ATUNE2 = 0) |
| CTSU 非計測チャネル出力 (POSEL) | GPIO LOW 出力 (POSEL = 0) |
| CTSU センサドライブパルス選択(SDPSEL) | 高分解パルスモード (SDPSEL = 1) |
| CTSU センサ安定待ち時間 (SST) | 64 μ s (推奨値) (SST = 0x1F) |
| CTSU マルチクロック制御 | 3 周波数 (MCA0,MCA1,MCA2:有効) |
| CTSU 計測時間 | 64 μ s (SNUM= 3) |

8. 消費電流測定

消費電流の測定方法および算出については、「RX140 グループ スマートウェイクアップソリューション (r11an0613jj0100)」の「6. 消費電力測定」をご参照ください。

改訂記録

| Rev. | 発行日 | 改訂内容 | |
|------|-----------|------|------|
| | | ページ | ポイント |
| 1.00 | Jul.29.22 | - | 初版発行 |
| | | | |

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違くと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、変更、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、変更、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限られません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとなります。
 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。